

創新資訊應用展示暨研討會

# The AI Nexus : 智鏈賦能・驅動未來

中華軟體公會今年首度打造大型AI解方博覽會，  
以AI技術、創新應用與多元產業需求，展示最新解決  
方案，串聯政府與產業交流媒合，共創智慧未來。

## 展示地點

### 主場·台北

10/30 (五)  
09:30-16:00

臺大醫院  
國際會議中心  
2F 201-205

### 巡迴·高雄

10/23 (五)  
13:30-17:00

亞灣新創園區  
3F 基隆+台中港

### 巡迴·台中

11/06 (五)  
13:30-17:00

思享空間  
2F 201-203

## 觀展贈好禮



**觀展早鳥禮**  
(上午50份/下午50份，共100份)  
7-11 100元禮券

**9名 高效菁英・隨行組**  
(各場次3名)  
7-11 500元禮券

**1名 台北場・頭獎**  
PayEasy享樂券 \$10000  
10,000元

**2名 中南部・頭獎**  
PayEasy享樂券 \$5000  
5,000元

**9名 品味紳活・保温杯**  
(各場次3名)

**15名 沁涼隨行・冰漏杯**  
(各場次5名)

## 展會亮點



### AI解方展示

30+ AI 廠商齊聚，  
一次掌握創新應用與科技趨勢。



### 四大展區探索

不只「AI智慧應用」！一次掌握  
「資安雲端」、「智慧治理」、  
「創新應用」多元解方。



### 論壇實績分享

熱門議題 × 實務案例  
掌握資安、AI及數位轉型新趨勢。



### 逛展集點好禮

逛展集點，好禮加碼！走訪攤位  
完成集點，抽大獎再享精美好禮！

## 公務人員專屬

### # 公務人員學習時數

主場提供8小時；中南部提供4小時學習時數

### 專屬媒合禮

7-11 200元禮券

公務人員(含國營事業單位)限定



預約媒合 | 完成即享媒合禮  
公務機關與會者可於活動前  
預約，活動當天完成媒合即  
可獲贈媒合禮。



### 論壇勤學禮

事前報名並參與論壇，  
主場前100名 / 中南部場前50名，  
即贈7-11 50元商品卡！



活動產品搶先報

活動窗口 |

黃資深專員

07-338-0948

abby.huang@tissa.org.tw



## 立即報名參觀



主辦  
單位



中華民國資訊軟體服務商業同業公會  
Taiwan Innovative Software and Services Association

贊助  
夥伴



與您相約，一同開創AI新未來！